

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 6 月 2 日(02.06.2016)



(10) 国際公開番号

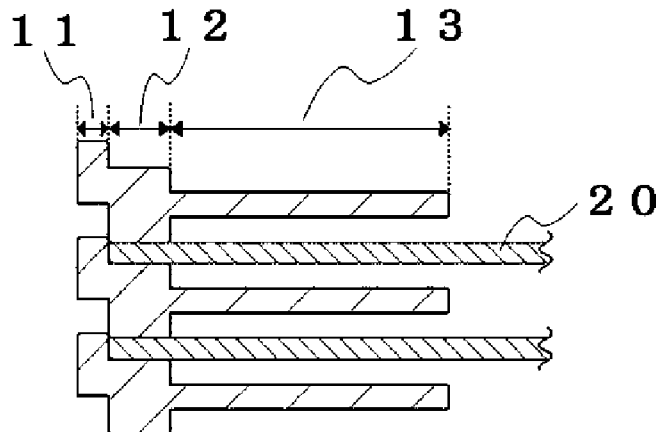
WO 2016/084882 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) H01L 21/673 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/083179
- (22) 国際出願日: 2015 年 11 月 26 日(26.11.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-240117 2014 年 11 月 27 日(27.11.2014) JP
- (71) 出願人: アキレス株式会社 (ACHILLES CORPORATION) [JP/JP]; 〒1698885 東京都新宿区北新宿 2-2 1-1 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 西島 正敬 (NISHIJIMA Masayuki); 〒1698885 東京都新宿区北新宿 2-2 1-1 Tokyo (JP). 立川 剛之 (TACHIKAWA Takayuki); 〒1698885 東京都新宿区北新宿 2-2 1-1 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 戸塚 朋之, 外 (TOTSUKA Tomoyuki et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 1-1 8-1 5 厚川ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: RING SPACER

(54) 発明の名称: リングスペーサー



(57) Abstract: [Purpose] To provide a ring spacer that makes it possible to transport a plate-shaped object such as a cover glass for an image sensor surface, or a semiconductor wafer having a 3DS-IC structure while minimizing damage or transfer to the surface of the plate-shaped object when the plate-shaped object is to be stored in a container and transported. [Structure] A ring spacer interposed between plate-shaped objects above and below in a container for storing and transporting a plate-shaped object, the ring spacer characterized in comprising at least a ring-shaped abutting section and a restricting section, the upper and lower surfaces of the abutting section being a substantially flat shape, the upper surface of the abutting section being in contact with the lower surface of the plate-shaped object at the peripheral edge and being a support surface for supporting the lower surface of the plate-shaped object at the peripheral edge, the lower surface of the abutting section being in contact with the upper surface of the plate-shaped object at the peripheral edge and being a pressing surface for pressing the upper surface of the plate-shaped object at the peripheral edge, and the restricting section having a restricting section upper surface positioned further outward than the outer contour of the plate-shaped object as viewed from above and positioned so as to project further upward than the support surface of the abutting section, and a restricting section lower surface positioned in a suitable location in the thickness direction of the abutting section.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2016/084882 A1



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

規則 4.17 に規定する申立て:

— 発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))

【目的】 イメージセンサー表面のカバーガラスや、3DS-IC 構造を持つ半導体ウエハなどの板状物を容器内に収納して搬送する場合に、これら板状物表面に転写や傷が付くのを抑制して搬送できるリングスペーサーを提供する。【構成】 板状物を収納して搬送させる容器内において、板状物の上下に介在されるリングスペーサーであって、リングスペーサーは少なくともリング状の当接部と規制部とを備え、当接部における上面および下面は、略フラット形状であり、当接部における上面は板状物の周縁部下面と当接し、板状物の周縁部下面を支持する支持面であり、当接部における下面は板状物の周縁部上面と当接し、板状物の周縁部上面を押さえる押さえ面であり、規制部は、平面視で板状物の外輪郭線よりも外方に位置し、かつ当接部の支持面よりも上方に突出して位置する規制部上面と、当接部の厚み方向の適宜箇所に位置する規制部下面とを有することを特徴とする。